



1

規格說明:

真空腔體 FIG.1 CHAMBER	 450 mm x 450 mm x 550 mm (W X D X H) 6" VIEW PORT BENCH TYPE WATER COOLED SUB. HEATER MAX : 500 C WITH ROTATOR SUB. HOLDER
抽氣系統 FIG.2 PUMPING STAGE	1. 820 L / SEC TURBO PUMP / OSAKA JAPAN 2. 928 L / MIN MECHANIC PUMP / ULVAC JAPAN
電子束 FIG.3 ULVAC JAPAN	1. CRUCIBLE : 4 X 10 CC 2. POWER SUPPLY : 5 KW / 4-10 KV 500 MA
真空計系統 FIG.4 VACUUM GAUGE	ION / DUAL CONVECTRON / DUNIWAY USA
膜厚計 FIG.5 THICKNESS MONITOR	THICKNESS MONITOR / MAXTEK USA

FIG 1. VACUUM CHAMBER :



FIG 1. VACUUM CHAMBER :



FIG 1. VACUUM CHAMBER :



FIG2. OSAKA JAPAN TURBO : 820 L / SEC MODEL: TG800F ULVAC JAPN MECHANIC PUMP : 928 L / MIN MODEL: D-950K





FIG3. ULVAC JAPAN E-BEAM POWER : 5 KW MODEL: HPS-510S E- BEAM : 4 X 10 CC MODEL: EGM-35M





FIG4. DUNIWAY USA ION / DUAL CONVECTRON MODEL: 934CV







FIG5. MAXTEK USA THICKNESS MONITOR MODEL : TM350R









人機界面控制操作:

1. 自動抽真空 / E-BEAM 坩鍋及材料名稱選擇:





- 一、螢幕下方有五個功能選項可供選擇設定,進入操作畫面時,手動操作選項會反白, 即可利用手動的方式來開啟或關閉MP、TB、RV、FV及MV閥門動作(紅色:關閉,錄色:開啟),也可以選擇自動抽氣方式來進行抽氣程序*TB圖案旁有一LED顯示 燈即為TB READY燈號,若TB暖機完成則會顯示紅色燈
- 二、螢幕右方有四個動作選項(坩鍋定位選項、加熱及馬達旋轉選項、E-Gun ready條件、旋轉載台定位選項)目前為坩鍋定位選項畫面,有四組ON、OFF定位開關每一 組開關旁皆可設定所放置的材料名稱,若選擇第一組開關ON,則在坩鍋畫面會顯示 第一個坩鍋已定位,以此類推選擇第四組開關ON,則在坩鍋畫面會顯示第四個坩鍋 已定位,ABORT為坩鍋定位失敗紀錄
- 三、在02閥門右邊有一流量計圖形,在右邊可設定通多少SCCM的氣體,閥門開啟後流量 計下方即會顯示實際流過的SCCM(白色數字為設定值,紅色數字為顯示值) 2010/4/20

2. 真空 / 加熱 (加熱定時)及載台旋轉轉速:





- 一、目前為H/R動作選項畫面,有三組ON、OFF開闢功能設定(加熱溫度設定、載台旋轉速度設定、腔體加熱時間設定),(白色數字為設定值,紅色數字為顯示值)
 *腔體加熱時間的溫度是依據加熱溫度所設定的溫度,即Baking開闢ON,Temp開闢也會跟著ON
- 二、破真空閥門(WV)右邊有一設定閥門delay開啟時間,其設定值須至参數設定選項中設定
- 三、SH1(SHTTER開啟/關閉閥門),若SHTTER開啟則電子槍圖形上方橫桿會消失,SHTTER 關閉則橫桿會顯示

3. 真空 / 電子槍 INTERLOCK 狀態:





一、目前為E-Gun Ready畫面,有四種條件需成立缺一不可

※高真空閥開啟:點燃ION GAUGE隨時監控腔體的真空度

- ※水流量:若坩鍋冷卻水未開啟即進行蒸鍍製程,很容易造成坩鍋本體受損,坩鍋冷卻 水需10L/min
- ※真空度:與934真空計控制器中的高真空設定點SET POINT1相關,若無到達所設定的高 真空設定點時其真空度燈號會熄滅,其用意是在要進行E-Gun蒸鍍製程時,腔 體真空度須保持在1.0E-4以下,若超過5.0E-4以上則不建議進行蒸鍍製程

※坩鍋定位:須至坩鍋定位完成方能進行蒸鍍製程

2010/4/20

17

4. 螢幕保護時間及各項參數選擇狀態:



5. 日期校正:



6. USER 權限設定: (出廠設定: 2/高,1/中.0/低)



7. 載台溫度 PID/ 自動 PID (AUTO TUNING) 設定



8. 各項保護延遲時間設定

Eas	yView
延 運 時 間 設 定	
1.自動抽氣下,TB管路壓力設定點到達後,FU延遲關閉時間: 6 sec	
2.自動抽氣下,腔體壓力設定點到達後,RV延遲關閉時間: 6 sec	
3.按下洩氣閥後,當MU及RU關閉後,UU延遲開啓時間: 10 sec	
4.MP啓動後,延運多少時間才可以開啓RV或FV: 5 sec	
5.MFC流量異常偵測,閥門開啓後延運多少時間才偵測: 5 sec	
6.坩鍋定位異常時間設定(到下一個坩鍋的時間): 20 sec	
7.坩鍋定位異常時間設定(轉一圈的時間): 60 sec	
8.TB開啓後,若管路壓力點消失後(回壓),延遲多少時間關閉TB: 10 se	C
9.轉盤定位異常時間設定〈到下一Holder的時間〉: 6 sec	EVIT
10.轉盤定位異常時間設定 (轉一圈的時間): 24 sec	

9. 系統錯誤及恢復狀態及時間履歷:





10. 坩堝定位控制:

開機程序說明:

1. Prepare

1-1 電力 3 x 220 min. 50 amp. 接地電阻 5 ohm 以下

1-2 冷卻水壓力 2 kg / cm 2 以上,流量 101 / min 以上

1-3 空壓 6-8 kg / cm2

1-4 製程氣體輸出壓力 0.5 kg/cm2 1/4" 接頭

1-5 機械幫浦抽氣煙霧排出裝置

2. Pumping

2-1 按下 人機 MP 啓動機械幫浦.

2-2 FV ON .

2-3 TURBO ON 至全轉速運轉33500RPM (此時 TURBO 旁READY 燈 ON).

2-4 啓動自動抽氣ON......此時所有 VALVES 自動程序開啓至所須高真空

(真空計 ION GAUGE ON)

3. Process

3-1 真空抽至製程壓力

3-2 O2 流量控制器 Valve on 設定流量

3-3 電子槍開啓小電流 材料預熔

3-4 膜厚計歸零 (Stop …. Start)

3-5 開啓 Shutter

3-6 手動控制電子槍電流及膜厚計之蒸鍍速率及總膜厚至所須膜厚為止

3-7 繼續其他坩鍋材料選擇及多層鍍膜

4. Chamber Vent

4-1 N2氣體鋼瓶開啓

4-1-1 按下 人機 Vent valve 經設定之延遲時間開始洩真空 至真空計 934 CV Gauge A 顯示 約 760 Torr
4-1-2 關閉 Vent valve

4-2 Stop 4-2-1 按下 人機 MV OFF.

4-2-2 TURBO OFF (此時 Turbo Pump Controller 顯示減速及倒數時間約 10 min)

4-2-3 待 Turbo 完全减速.

4-2-4 FV OFF.

4-2-5 MP OFF

4-2-6 MP OFF 時 管路洩壓 VALVE 會自動洩壓

4-2-7 關閉主電源

電子束控制器操作:



操作順序說明:

- 1. 主電源 ON / OFF 開闢
- 2. 電子束使用時間累計
- 3. LUCK / LOCAL / REMOTE 選擇
- 4. 高壓 ON / OFF
- 5. 高壓 METER (UNIT: KV 4-10 KV)
- 6. 電流 METER (UNIT: MA 0-500 MA)
- 7.X,Y磁場及電子束點位置
- 8. INTERLOAK 狀態指示燈
- 9. 手握搖控器 REMORE HANDS
- 10. 電子束參數設定(建議勿隨意更改)



REMOTE HAND

11. 調整電子束之水平位置及掃瞄12. 調整電子束之垂直位置及掃瞄13. 調整電子束之電流大小以控制蒸鍍速率

















934 vacuum gauge controller



◆ION GAUGE:高真空離子式真空計 ◆GAUGE A:低真空對流式真空計(convection gauge)偵測腔體壓力 ◆GAUGE B:低真空對流式真空計偵測Turbo pump的管路壓力 ◆FILMENT:高真空離子式真空計啟動鈕 ◆DEGAS: 不論粗抽或精抽腔體時, 會有一些氣體分子附著於離子式真空 計中,利用DEGAS功能則可將氣體分子去除,使其真空度變佳 ◆FILMENT SET PT:離子式真空計自動點燃設定點(一般是不會設定自 動點燃,因為常點燃離子真空計會減少其壽命) ◆SET POINT1,2:高真空度壓力到達設定點時, ION GAUGE display左 邊 led 燈亮 ◆GAS FACTOR: 氣體因子 ◆GAUGE SENSITIVITY:真空計的敏感度 ◆GAUGE A SET PT:當腔體壓力到達設定點時則1ed燈亮 ◆GAUGE A ZERO:低真空對流式真空計歸零校正 ◆GAUGE A ATMOS:低真空對流式真空計大氣壓力校正

◆GAUGE B SET PT:當Turbo pump管路壓力到達設定點時則1ed燈亮
◆GAUGE B ZERO:低真空對流式真空計歸零校正
◆GAUGE B ATMOS:低真空對流式真空計大氣壓力校正
◆SELECT:功能選擇鍵

◆RAISE、LOWER:增加和減少鍵

MAXTEK THICKNESS MONITOR TM-350膜厚計

SHUTTER	RATE			THICKNESS				SENSOR
POWER				MODIFY				
T	START	SHUTTER	FILM		MATERIAL DENSITY	THICKNESS	F2	
0	STOP	DISPLAY	F1		ACOUSTIC IMPEDANCE	TOOLING FACTOR	F3	
	SS MONITOR	4			4	<u>s</u>	AXTER	
RATE:頻率顯示螢幕				MATERIAL DENSITY:材料密度輸入鍵				
THICKNESS:膜厚顯示螢幕				ACOUSTIC IMPEDANCE:音響阻抗輸入鍵				
START:量測膜厚開始鍵				THICKNESS ENDPOINT:設定量測鍍膜的厚度				
STOP:	停止量測膜	厚鍵		TOOLIN	G FACTOR 3	設定膜厚	計感測頭	的量測
SHUTTER:遮板開啟/關閉鍵				位置點				
MODIFY:增加/減少鍵				FILM NUMBER:可以儲存0~99組鍍膜的材料				
DISPLA	Y:石英震盪	量晶片頻率	及健康度	顯示				
	2010/4/20							41

膜厚計操作說明

- 一、膜厚計POWER打開,若所有裝置都正常則右上方有一SENSOR LED燈 會亮綠燈,若有問題則顯示橘紅色燈,此時請檢測石英震盪晶片是否 放置不正確或膜厚計的CABLE未接好
- 二、在RATE DISPLAY會出現P, THICKNESS DISPLAY會出現FALL此為正常訊息,按下STOP鍵即可消除,若出現0、 FALL錯誤訊息則與第一步驟相 同檢測方式
- 三、按START開始量測膜厚
- 四、SHUTTER鍵是控制坩鍋上方的遮板開啟與關閉與THICKNESS ENDPOINT鍵 配合使用,但此系統的SHUTTER開啟與關閉是由人機介面所控制所以膜 厚計上的SHUTTER鍵與THICKNESS ENDPOINT鍵是無法使用,故膜厚計左 上方有一SHUTTER LED燈會呈現橘紅色
- 五、按一下DISPLAY鍵, 膜厚計中間的FREQ LED燈會亮, RATE DISPLAY會出 現石英震盪晶片的頻率數(新的石英震盪晶片頻率為6MHZ), 再按一 次DISPLAY鍵則TEST燈亮, 即測試目前石英震盪晶片的頻率和健康度, 例如出現6-99即表示6MHZ, 健康度為99

六、FILM NUMBER、 MATERIAL DENSITY、 ACOUSTIC IMPEDANCE三個鍵需 配合使用,例如按FILM NUMBER利用MODIFY鍵來選擇第幾組設定之後 按MATERIAL DENSITY鍵輸入要量測鏡膜材料的密度(查表得知), 再按ACOUSTIC IMPEDANCE鍵輸入要量測鏡膜材料的音響阻抗(查表 得知)即設定完成

七、TOOLING FACTOR鍵,第一次使用膜厚計都需做此校正,即將膜厚計 感測頭擺置與載台相同高度,在TOOLING FACTOR輸入設定100即量測 鍍膜位置為1:1,鍍完膜後須將試片拿出用精密儀器量測膜厚是否 與膜厚計所顯示的膜厚一樣,若不一樣再按TOOLING FACTOR改變比 例值,直到相同為止,之後則不需再做此校正,除膜厚計感測頭或 載台位置變動